

龍華科大半導體工程系 為14產業培育人才

李侑珊／台北報導

為因應半導體相關產業需求，龍華科技大學半導體工程系自112學年度開始招生。課程將以功率半導體元件、半導體製程與材料、IC封裝與測試為主軸，研究領域涵蓋化工與材料應用、產線智慧化等專業領域，培育學生具備半導體製程與封測專業知識技能，以達成國家半導體產業所需專業實務人才的教育目標。

龍華科大近日與日月光半導體、台積電、南亞科技、穩懋半導體等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，共同成立「半導體產學及人才培育聯盟」，盼藉由產學合作，加速培育國內半導體專業技術人才，並提升學子職場競爭力。



龍華科大與日月光半導體、台積電、南亞科技等14家半導體龍頭及關鍵領域產業，共同成立「半導體產學及人才培育聯盟」。

(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

龍華科大校長葛自祥表示，台灣半導體產業規模位居全球第二大，根據工研院產科國際所預估，今年我國半導體業總產值可達新台幣4.7兆元，明年預期將突破5兆元，包括晶圓代工、IC設計、封裝測試等都有成長動能，產業人才需求非常殷切，學校因此成立「半導體教學中心」，致

力育才。

對於與14家半導體相關產業締結產學合作關係，龍華科大行政副校長林如貞代表董事長孫道亨表達感謝。

林如貞提到，龍華科大今年獲教育部補助1億元，建置「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」，將整合該

校現有的「3D數位電路板設計暨智慧製造類產線工廠」及「(5G)行動通訊模組測試與調校類產業環境工廠」兩座教育部產業菁英訓練示範基地，以及半導體特色場域等實驗室設備，不僅協助產業升級，更深化產學研發成果，為國家高科技發展做出更多貢獻。